

证书号第18896011号



实用新型专利证书

实用新型名称：晶粒封装结构

发明人：廖皇顺

专利号：ZL 2023 2 0087980.8

专利申请日：2023年01月30日

专利权人：力勤股份有限公司

地址：中国台湾新北市

授权公告日：2023年04月25日

授权公告号：CN 218918844 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第18896011号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月30日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

力勤股份有限公司

发明人：

廖皇顺